



## Inyección de placas de anclaje y fisuras en la Ciudad de Telecomunicaciones de Telefónica

Betazul ha realizado la inyección de placas de anclaje y fisuras en la Ciudad de Telecomunicaciones de Telefónica mediante la aplicación de la resina epoxi de baja viscosidad Sikadur 52 Inyección

El primer paso en el caso de los trabajos de inyección de fisuras es el sellado superficial de éstas. Esta operación se realiza para encapsular la fisura, de tal forma que la resina de inyección que se vaya a introducir no tenga posibilidad de escaparse. El producto que se utilizó en este caso fue la resina epoxi Sikadur 31.

A continuación se colocan los inyectores, que pueden ser de plástico o metálicos, con una separación entre ellos que depende del espesor del elemento que se vaya a inyectar. Estos inyectores se colocan pegados con la resina epoxi. Se debe obturar superficialmente la fisura entre tramos de éstos con Sikadur-31 para evitar la pérdida de resina durante el proceso de inyección .

Finalmente se inyecta la resina, a través de los inyectores, empezando de abajo hacia arriba de la fisura. El producto más adecuado a utilizar es la resina epoxi de baja viscosidad Sikadur 52 Inyección. La inyección se puede hacer con un calderín que le impone presión a la resina o por medios manuales, con una pistola de extrusión. Tan pronto como la resina rezuma por el siguiente inyector, el primero se debe sellar y continuar el proceso de inyección desde el siguiente.

Después de completar el proceso de inyección, los inyectores y el material de sellado se pueden eliminar.



Nombre de la Obra	Ciudad de las Telecomunicaciones de Telefónica.
Empresa Aplicadora	Betazul, S.A.
Fecha inicio de la Obra	25 de enero de 2006
Fecha finalización de la Obra	14 de julio de 2006
Propiedad	Telefónica
Constructora	Ute Ciudad de las Telecomunicaciones
Proceso	Realización de inyección de placas de anclaje e inyección de fisuras con Sikadur 52 inyección.